

P. 2 上から2行

訂正 誠の有り難い → 誠に有り難い

P.55 表 4.1

訂正
誤

表4.1 導体の断面積と抵抗値

対象		半導体				プリント配線板					
断面積(μm ²)	パターン長さ(μm)	0.065		0.05		50.00		100.00		150.00	
		幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ
20,000						17.4000		8.7000		5.8000	
10,000		2676.923		267.692		3.4800		1.7400		1.1800	
1,000		267.692		26.769		0.3480		0.1740		0.1180	
	100	26.769		2.677		0.0348		0.0174		0.0118	
	30	2.677		0.268		0.0035		0.0017		0.0012	
断面積(μm ²)		0.065		0.05		50.00		100.00		150.00	
パターン幅と厚さ(μm)		幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ
		0.05	1.30	0.05	13.00	0.70	71.43	0.70	142.86	0.70	0.00
		0.07	0.93	0.07	9.29	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	0.00
		0.10	0.65	0.10	6.50	3.00	16.67	3.00	33.33	3.00	0.00
		0.13	0.50	0.13	5.00	5.00	10.00	5.00	20.00	5.00	0.00
		0.18	0.36	0.18	3.61	7.00	7.14	7.00	14.29	7.00	0.00
		0.20	0.33	0.20	3.25	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	0.00
		0.25	0.26	0.25	2.60	15.00	3.33	15.00	6.67	15.00	0.00
						20.00	2.50	20.00	5.00	20.00	0.00
						25.00	2.00	25.00	4.00	25.00	0.00
						30.00	1.67	30.00	3.33	30.00	0.00
						50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	0.00
				75.00	0.67	75.00	1.33	75.00	0.00		
				100.00	0.50	100.00	1.00	100.00	0.00		

誤記

正

表4.1 導体の断面積と抵抗値

対象		半導体				プリント配線板					
断面積(μm ²)	パターン長さ(μm)	0.065		0.05		50.00		100.00		150.00	
		幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ
20,000						17.4000		8.7000		5.8000	
10,000		2676.923		267.692		3.4800		1.7400		1.1800	
1,000		267.692		26.769		0.3480		0.1740		0.1180	
	100	26.769		2.677		0.0348		0.0174		0.0118	
	30	2.677		0.268		0.0035		0.0017		0.0012	
断面積(μm ²)		0.065		0.05		50.00		100.00		150.00	
パターン幅と厚さ(μm)		幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ	幅	厚さ
		0.05	1.30	0.05	13.00	0.70	71.43	0.70	142.86	0.70	214.29
		0.07	0.93	0.07	9.29	1.00	50.00	1.00	100.00	1.00	150.00
		0.10	0.65	0.10	6.50	3.00	16.67	3.00	33.33	3.00	50.00
		0.13	0.50	0.13	5.00	5.00	10.00	5.00	20.00	5.00	30.00
		0.18	0.36	0.18	3.61	7.00	7.14	7.00	14.29	7.00	21.43
		0.20	0.33	0.20	3.25	10.00	5.00	10.00	10.00	10.00	15.00
		0.25	0.26	0.25	2.60	15.00	3.33	15.00	6.67	15.00	10.00
						20.00	2.50	20.00	5.00	20.00	7.50
						25.00	2.00	25.00	4.00	25.00	6.00
						30.00	1.67	30.00	3.33	30.00	5.00
						50.00	1.00	50.00	2.00	50.00	3.00
				75.00	0.67	75.00	1.33	75.00	2.00		
				100.00	0.50	100.00	1.00	100.00	1.50		

正

P.100、図 7.11

変更

右側の「プレス圧力の数字」は削除し、「arbitrary unit」とする

P.112、上から 11 行

追加

「超音波洗滌の適用する場合は基板材料の状況を考慮することが必要です。」

P.155、下より 1 行目

挿入

・・・酸洗「や化学処理、場合より、プラズマ処理」を・・・

P.159、上より 3 行目

追加

「液状ソルダーレジスト用いる場合、スルーホール内に入らないように注意が必要です。」

P.174 下から9行

訂正 「基絶縁板」 → 「絶縁基板」

P.201 上から 4 行目

追加

「... プリプレグを作ります。」 の次に、
「(C)のノボラック型エポキシ樹脂を用いるものもあります。」
を追加

P. 202 図14. 5

訂正

「(b) 熱硬化性ポリイミドの構造」 → 「(a) 熱硬化性ポリイミドの構造」
「(a) BT樹脂に構造(推定)」 → 「(b) BT樹脂に構造(推定)」

P.220 上から9行

削除

「1990 年ころより、よりビルドアップ」 → 「1990 年ころより、ビルドアップ」

P.240 下から8行

訂正

「高度密度配線」 → 「高密度配線」

P. 246、上より 6 行目

訂正

「ベントリアジン」 → 「ベンゾトリアジン」